

证券代码：688981

证券简称：中芯国际

中芯国际集成电路制造有限公司  
投资者关系活动记录表

|                      |   |
|----------------------|---|
| 投资者关系活动类别            | <input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议<br><input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会<br><input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动<br><input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 电话会议<br><input type="checkbox"/> 其他（    ） |
| 参与单位名称               | 华泰证券、中信证券、中金证券、东方证券及通过电话和网络参加会议的各界人士。根据业绩说明会平台统计，电话拨入和平台连接合计共有709位投资者。  |
| 时间                   | 2026年5月15日  |
| 地点                   | 网络/电话会议   |
| 公司接待人员姓名             | 联合首席执行官赵海军博士、资深副总裁兼董事会秘书郭光莉女士、资深副总裁兼财务负责人吴俊峰博士  |
| <b>投资者关系活动主要内容介绍</b> |   |
| 公司介绍                 | <p>中芯国际（证券代码：00981.HK/688981.SH）是世界领先的集成电路晶圆代工企业之一，也是中国大陆集成电路制造业领导者，拥有领先的工艺制造能力、产能优势、服务配套，向全球客户提供8英寸和12英寸晶圆代工与技术服务。中芯国际总部位于中国上海，拥有全球化的制造和服务基地，在上海、北京、天津、深圳建有多座8英寸和12英寸晶圆厂。中芯国际还在美国、欧洲、日本和中国台湾设立营销办事处、提供客户服务。</p> <p>详细资讯请参考中芯国际网站 <a href="http://www.smics.com">www.smics.com</a>。</p>                       |
| 交流问答                 | <p>（在此提醒各位，我们今天的表述，包括了前瞻性陈述，是对公司未来业绩的预期，而非保证，并受固有风险和不确定因素的影响。请参阅我们业绩公告中的前瞻性陈述。除非另有说明，业绩说明会的数据根据国际财务报告准则表述的，货币以美元表示。）</p> <p>▪ 资深副总裁、财务负责人吴俊峰博士发言：</p> <p>大家好。首先，我向大家汇报2026年第一季度未经审核业绩，然后给出第二季度指引。</p> <p>一季度业绩如下：<br/>销售收入为25.05亿美元，环比增长0.7%。</p>   |

毛利率为 20.1%，环比增长 0.9 个百分点。  
经营利润为 2.48 亿美元。  
息税折旧及摊销前利润为 14.35 亿美元，息税折旧及摊销前利润率为 57.3%。  
归属于本公司的应占利润为 1.97 亿美元。

关于资产负债，在一季度末：

公司总资产为 550 亿美元，其中库存资金 139 亿美元。  
总负债为 192 亿美元，其中有息负债为 145 亿美元。  
总权益为 358 亿美元。  
有息债务权益比为 40.5%，净债务权益比为 1.8%。

关于现金流量，在一季度：

经营活动所得现金净额为 6.85 亿美元；  
投资活动所用现金净额为 16.97 亿美元；  
融资活动所得现金净额为 23.65 亿美元。

关于 2026 年二季度，我们的指引如下：

销售收入预计环比增长 14%到 16%，毛利率预计在 20%到 22%之间。

以上是公司财务方面的情况。接下来，就公司 2025 年度报告相关事项说明如下：根据上海证券交易所相关规定，上市公司年度报告期内盈利且累计未分配利润为正、未进行现金分红的上市公司，应当在年度报告披露之后、年度股东会股权登记日之前的业绩发布会中，就现金分红方案相关事宜予以重点说明。

2025 年，公司经营性现金流扣除资本开支后的自由现金流仍为负值，表明当前公司仍处于产能扩建、持续提升市占率的关键阶段，产能建设与研发活动仍需持续投入资金。2026 年，公司预计资本支出规模与上年基本相当。在此投资规划下，现阶段公司仍需优先保障产能建设与研发活动等核心业务的资金投入。此举将助力企业核心竞争力与价值的持续增强，确保在激烈市场竞争中保持领先优势，从而最大限度保障投资者权益。因此，公司决定 2025 年度不实施利润分配，该安排更契合公司长远发展需求与股东根本利益，亦符合相关法律法规、规范性文件及公司利润分配政策，不会损害公司及股东权益。本方案经董事会审议通过并载于年报，后续将提交年度股东会审议。特此感谢全体股东的理解与支持。

▪ 联合首席执行官赵海军博士发言：

大家好，欢迎参加中芯国际 2026 年一季度业绩说明会。

一季度，公司实现销售收入 25.05 亿美元，环比增长 0.7%。以服务类型来看，晶圆收入占总收入比重的 93.9%，金额环比增加 2.3%，其中，出货数量环比下降 0.2%，晶圆平均销售单价环比提升 2.5%，主要是公司在

优势细分领域的部分产品代工价格稳中有升。一季度，公司新增近 9 千片折合 12 寸的产能，公司整体利用率为 93.1%，环比下降 2.6 个百分点，主要原因有两个：一是受人工智能虹吸效应影响，去年四季度手机厂商担忧配套存储芯片供应不足而下调订单，这个影响部分传导到第一季度；二是因为一季度有新厂出开办期，对应产能加入到利用率的分母中。

一季度，公司销售收入以地区分类看，中国、美国、欧亚占比分别为 89%、9%和 2%，从金额来看，中国区收入环比增长 2%，持续体现产业链重组带来的效应。晶圆收入按尺寸分，十二英寸和八英寸占比分别为 76%和 24%，从金额来看，8 英寸晶圆收入环比增长 6%，主要是因为人工智能对配套芯片需求强劲，以及对其他产能供应的挤压，使得公司收到的订单增加，产能供不应求，BCD、逻辑、嵌入式存储收入均实现环比增长。晶圆收入以应用来看，智能手机、电脑与平板、消费电子、互联与可穿戴、工业与汽车收入占比分别为 19%、14%、46%、7%和 14%。顺应市场变化，公司将产能更多的调配给 BCD、存储等需求旺盛的平台，使得电脑与平板、工业与汽车收入环比分别增长 18%，而智能手机收入环比下降 10%。

一季度毛利率为 20.1%，环比增加 0.9 个百分点，主要因为销售单价上升和产品结构优化。

结合当前形势，在供不应求的产品类别，公司与客户协商上调定价，涨价效应逐步显现；加之部分客户顾虑后续外部环境不确定性可能带来供应不足或继续推高供应链价格，提拉消费、IoT 产品备货，使得公司在手订单充足。综合以上因素，二季度，公司给出的收入指引为环比增长 14%到 16%，预计出货量和平均销售单价均有明显提升；毛利率指引为 20%-22%，与上一季指引相比提高 2 个百分点，主要是因为平均销售单价的上升。

在产品平台方面，公司持续发力做好布局。近两年 AI 热潮直接带动电源管理、数据传输等芯片需求，同时挤压 NOR Flash、SLC NAND 存储器产能供应链，使得公司独立式闪存工艺平台及模拟工艺平台需求旺盛。公司车规工艺布局全面，覆盖逻辑、模拟 BCD、嵌入式存储、独立式闪存、显示驱动、图像传感器、功率器件等，经多年打磨，逐步放量，尤其车规模拟 BCD 平台需求旺盛，订单饱满。公司 ToF 产品在车载激光雷达、手持影像设备中大规模应用。公司 Micro OLED 平台产品，已经应用在智能头戴显示、AI 眼镜等新兴显示产品中。公司超低功耗逻辑工艺平台产品，为云端 AI 以及边缘 AI 应用提供了有线及无线连接解决方案。

基于客户需求和在手订单情况，相较于上个季度，公司对于今年的整体运营情况更加乐观。主要是因为，第一：人工智能对配套芯片的强劲需求，直接推动公司电源管理芯片产能供不应求；第二：人工智能海外虹

吸效应使得消费、IOT 等客户在大陆寻找产能、订单回流；第三：人工智能亦带动 ToF、电动汽车、机器人等新应用需求，本土公司积极开拓市场；第四：产业链国产化诉求，推动国产逻辑、网通等芯片需求；第五：涨价效应以及之前提到的客户因担忧以后的供应不足而提前备货。在市场环境变化的情况下，公司的技术储备、平台多元和产能转换灵活性的优势，支撑了公司接收订单的能力。我们把产能切换到逻辑、专用存储、电源管理、AFE 模拟平台、高精度 ADC 转换器、Micro OLED 等持续迭代的产品上来。公司继续推进产能建设，与客户签订长期协议，锁定未来需求，为公司带来稳健的增长动能。

当前全球宏观环境仍面临诸多不确定性，对供应链成本、稳定性、市场预期等带来持续挑战。延续这些年的经验积累，我们会持续强化供应链韧性管理，多渠道采购，尽最大努力降低影响。同时，公司将紧密跟踪客户需求，灵活调配资源，加快产品响应速度，确保在复杂环境中依然能保持高质量的交付。

此外，我们和各位一起回顾一下过去一年公司的市值管理情况。公司高度重视市值管理工作，于 2025 年一季度制定了《市值管理制度》并相应执行。过去一年，公司持续聚焦主业，经营业绩再上新台阶；持续推动技术攻关，协同产业链共同发展；持续建设加强人才队伍，全面推动绿色可持续发展；深化投资者与公司的双向沟通，通过线上线下多种方式积极向资本市场传递公司价值。

最后，我们依然要感谢客户、供应商、投资者，以及社会各界对公司的理解和大力支持。谢谢大家。

▪ 问答环节：

问题 1：恭喜公司非常好的业绩。刚刚几次听到人工智能配套芯片这个讲法，能否进一步展开讲讲具体包括哪些产品？公司具有什么样的技术平台和客户优势来抓住这一波人工智能配套芯片的需求？公司目前折旧压力非常大，这次能够实现毛利率的提升是非常不易，后续几个季度毛利率趋势如何？

回复：中芯国际在电源管理、电源供应、数据传输和数据驱动部分有大量客户并占有主流市场较大份额。随着端侧人工智能需求的带动，目前我们的产能供不应求。例如 ToF、逻辑电路、电源供应、电源管理等技术和平台广泛应用在汽车、消费电子等和人工智能端侧相关的应用场景。

毛利率方面，我们从两个方面来加强。第一，在一些细分赛道我们是龙头，不仅技术领先，也与客户合作较早，产品质量和性能更优，因此也带来了更多的订单和高价的产品。第二，随着市场需求的提升，我们也与客户协商上调价格，涨价效应在二季度有明显体现，三四季度体现的更多。2026 年预计全年的折旧比去年增加 30%左右，结合刚刚提到的这

两个因素，以及叠加出货量增加的综合效应，我们力争毛利率稳中有升-这是我们努力的一个方向。

问题 2: 关于存储大周期的影响，目前看来终端客户是否已习惯存储的高价，下单意愿是否有边际的改善？部分存储厂把产品线更多切换到 HBM 等高阶产品，公司作为有竞争力的特殊存储代工厂，是否有规划加大投入抓住特殊存储的市场空缺的机会？

回复：我目前没有看到市场松动，可能因为 AI 产业的发展速度超过我们上个季度的预测，也有可能存储中间商手中的存货至今没有释放，可能在进一步增加库存，但这是我们的猜测，没有特别多的数据支持。我们所处的整个市场中，专用存储器产能被挤压了，许多原本生产专用存储器的 IDM 厂商已不再生产，导致通用和专用市场都供应紧张。

中芯国际正在建设相关产能。我们的特点在于灵活性，即开发专用存储器产能时，约 90%的设备与工艺可与现有的逻辑电路兼容，仅需增加约 10%的专用设备，即可将整条产线切换过来。

当前面临的问题是，现有逻辑电路、MCU 等产线本身也已满载，无法直接切换产能。因此，我们只能在总产能扩大的基础上逐步切换一部分去做特殊存储。这项工作正在稳步推进，基本上每个季度特殊存储的占比都高于上一季度，但仍处于供不应求状态。

问题 3: 公司在一季度分别成立了先进封装研究院和子公司“上海芯三维半导体”，请问公司在先进封装、3D 集成、2.5D 集成这一块工艺布局有哪些规划，未来是如何考量的？

回复：中芯国际从 2015 年就开始布局封装和先进封装。我们曾经投资了国内的封测龙头，也专门建立了合资公司做 12 寸的 Bumping（凸块加工）和 2.5D 封装等。但中芯国际的发展速度非常快，我们更加聚焦于自己客户在前端需要的封装技术，因此在过去十年里我们一直在进行 3D 领域的 CIS 键合封装，主要通过把一个 CMOS Image Sensor 跟另外一个标准逻辑 ISP Image Sensor Processor 通过后部处理键合在一起；并且我们也为先进封装厂提供 Interposer（中介层）。

现在基于客户需求，我们做了一个总体的规划，最近主要是部署了两件事：一是成立先进封装研究院，主要希望对前沿的技术、前端的发展趋势能够加深研究；第二是我们成立了芯三维，来建立一些配套产能，满足中芯国际现在客户的需求。对行业出现的机会，公司也会密切的关注，紧密贴合中芯国际客户的需求，灵活推进相关的业务布局。

问题 4: 从工艺平台的角度是按照怎样一个顺序，平台之间哪些是可以互相转换的？您前面提到的 ToF 平台是从什么时候开始布局的？有哪些新的技术应用？

回复：代工行业在摩尔定律驱动下，标准逻辑电路总是最先出现并率先成熟，随后每两年左右迁移到下一代节点。如果不是领先进入某个节点，只做标准逻辑电路，订单和价格往往不足以支撑一个新工厂的发展，必须尽快开发衍生产品和嵌入式产品。因此通常的节奏是：第一波以标准逻辑电路为主，追求速度；第二波转向超低功耗，速度不要求最快，但功耗极低。然后加入 5%-10% 的模拟电路，主要用于网通和射频领域。此后，再加入嵌入式、加入高压做高压驱动、加入 BCD 来做功率，加入光电来做传感，逐步丰富产品组合。

ToF 实际上就是加入光学的检测器件。那这个部分主要是国内涌现出来的需求，电动车或者机器人的视觉部分是需要 ToF 技术的，也有一些用到手机上的传感器，例如你拿起手机往耳朵边一放，它的各种功能就启动了。在汽车的测距部分，还有机器人的视觉应用方面，还在启动阶段，但我们觉得这也是很好的一个应用领域，中芯国际在这个领域里面花了很长时间来跟客户一起去调试器件、开发产品，现在已经看到上量了。

问题 5：我想请教公司目前是否有海外客户为了“local for local”的趋势以及全球产能挤压的效应在我们这里进行投产的？关于产能挤压的效应，趋势怎么演变的，会持续多久？在当下能够占到我们总需求的百分之多少？

回复：当前全球产能紧张，主要原因是 AI 相关需求旺盛且利润较高，导致许多代工厂及 IDM 厂商纷纷将产能切换到 AI 或 HBM 相关领域，留给标准产品及既有产品的产能明显减少。原本在海外代工的产品因此难以继续生产；相比之下，中国国内还是有半导体产能，因此我们看到大量海外客户将订单转移到中国国内来制造。我们也看到，许多存储器工厂原本也生产专用产品，但现在宣布退出民用市场或终止原有产品线。这使得那些使用少量多样、专用 NOR Flash 和 NAND Flash 的公司陷入恐慌。这部分需求正转向中国国内，并主要集中于以中芯国际为代表的主流生产厂商。目前挤压效应还不是最严重的，随着 AI 主芯片及边缘应用的需求持续扩大，非 AI 领域的产能可能被进一步挤压，这一趋势具有长期性。至少今明两年，大量包括手机、电脑、IoT 及网通类等产品的生产需求将出现明显回流，而中国本土产能建设快、规模大，有能力承接大量回流的订单。

问题 6：中芯北方的少数股权收购现在到了哪一步了？咱们预计什么时候会完成全额计入？时间点可能是在哪个季度发生？

回复：中芯北方股权收购的进展情况如下，5 月 11 日，该事项已获得上交所并购重组委审议通过，并已提交至证监会进行注册，但注册完成的具体时间尚不确定。因此，在一季度，中芯北方的利润仍按 51% 的比例并入我们的归母净利润。待注册通过并完成交割后，中芯北方的利润将全部 100% 计入归母净利润。整体来看，北方股权的上翻对归母净利润、每股收益以及净资产收益率等财务指标均为有利，届时这些指标将有所提升。

|                        |  |
|------------------------|--|
|                        | <p>问题 7: 我们测算了一下, 8 寸在一季度的营收有 6% 的增长, 想请教一下, 这个是因为主要是单价提升, 还是说是价量方面都有表现? 此外, 我们看到上游公司例如硅片厂在 8 寸这块对市场的展望不是特别的乐观。所以想请教您怎么看 8 寸的后续趋势的需求和价格趋势?</p> <p>回复: 公司 8 英寸产线大约自去年二季度至今一直处于满载状态。由于我们没有扩建 8 英寸产能, 目前只做两件事: 一是进行产品结构调整。针对某些模拟电路、光罩层数少, 但占用瓶颈机台较多, 我们会与客户协商, 要么提高价格, 要么减少产量, 这属于优化产品组合; 二是根据市场发展情况以及客户自身产品在市场上的竞争力, 与客户协商提升价格。目前看到的 6% 增长, 主要来自于价格提升。</p> <p>我们看到国际上 8 英寸产线的整体利用率并不高, 但中芯国际的情况具有两点特殊性。第一, 我们的 8 英寸产线是后建的, 设备较新, 竞争力很强。第二, 我们在建设产能时并非针对标准逻辑电路, 而是根据客户的实际需求来布局, 客户不需要的产能我们没有建设。因此, 现有产能主要用于质量要求高、性能最新的领域, 且主要是人工智能建设过程中的直接需求。我们看到这些直接需求正随季度持续增加。如果行业对 AI 发展的预测准确, 即建设投资持续到 2030 年左右, 那么未来几年这方面的需求只会越来越大, 而非减少。因此, 我们有信心认为, 相关订单的持续性较好。</p> <p>问题 8: 公司一季度的折旧和摊销的金额是环比上升的, 怎么理解它与构成销售成本中的折旧与摊销趋势不同? 另外关于全年的折旧是不是有一些更新?</p> <p>回复: 中芯国际每一元钱的销售额里面的折旧占比是在增长的。我们现在能够维持毛利率水平或者更高, 主要是产品优化、保持高产能利用率以及价格的增长带来的 ASP 提升。</p> <p>具体从财务角度看, 持续进行产能扩建, 新机台设备陆续投入生产, 导致总折旧增加。一季度收入增长, 出货量略有下降, 存货中的在产品和产成品有所上升。因此, 总折旧中有一部分计入了存货, 导致出货部分对应的销售成本中折旧相对减少。这就是一季度总体折旧和摊销与销售成本中的折旧和摊销趋势不同的原因。总体来说, 我们预计全年折旧增加约三成, 一季度增幅为 26%, 后续几个季度折旧将持续增加, 全年折旧指引维持不变。</p> <p>如需了解完整版业绩说明会, 请在业绩发布一年内访问中芯国际官网收听完整版语音记录。</p> |
| <p>是否涉及应当披露重大信息的说明</p> | <p>沟通内容基于公司已公开披露信息。</p>  |